

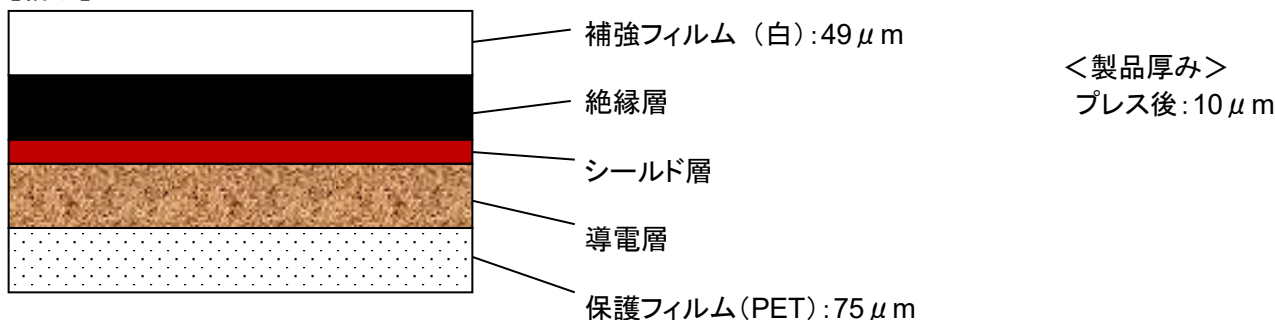
LIOELM®TSS500Z K2

【特徴】

本製品は、高速伝送用に設計されたシールドフィルムで、高屈曲性、鉛フリー半田耐熱性を有する FPC 用電磁波シールドフィルムで、伝送ロスを低減します。

高速通信が要求されるアンテナモジュールや USB モジュール用の FPC に最適な材料です。

【構成】



【物性】

製品名	TSS500Z K2
補強フィルム	49um PET
絶縁層	特殊ウレタン系絶縁層 4 μ m $\pm$ 2 μ m
シールド層	金属層 2 μ m
導電層	特殊ウレタン系導電層 4 μ m $\pm$ 2 μ m
保護フィルム	75um PET
製品厚み(プレス前)	11um $\pm$ 4
製品厚み(プレス後)	10um $\pm$ 3
シールド性	80dB (1GHz)
表面抵抗値	50m Ω /□ 以下
接着力 (PI)	3N/cm 以上

上表の値は実測値であり保証値ではございませんので、実用に際しては確認を行って下さい。

<接着力測定条件>

- 構成: Kapton200H/(導電層側)TSS(絶縁層側)/Adhesive sheet/Kapton200EN
- プレス工程: Laminate 90°C→Press 170°C-2MPa-30min
- 引張速度 : 50mm/min
- 引張角度:90°

【使用方法 (クイックプレス)】

- 1) 導電層側の保護フィルムを剥離します。
- 2) FPCと貼り合わせます (仮貼り)。
- 3) 3分以上真空中で補強フィルムを付けた絶縁層側からプレスします。
- 4) 補強フィルムを剥離します。
- 5) ポストキュアを行います。

【使用方法 (プレスのみ)】

- 1) 導電層側の保護フィルムを剥離します。
- 2) FPCと貼り合わせます (仮貼り)
- 3) 補強フィルムをつけた絶縁層側からプレスします。
- 4) 補強フィルムを剥離します。

【推奨プレス条件】

	プレス条件			ポストキュア	
	温度	圧力	時間	温度	時間
クイックプレス & ポストキュア	170±10℃	2MPa	More than 3min	160±10℃	1h 以上
プレスのみ	170±10℃	2MPa	More than 30min	-	-

【製品の保管について】

- ・ 10℃の保冷環境下で保管して下さい。
- ・ 保冷保管環境から室温に戻してご使用下さい。推奨時間は7時間です。
- ・ 打ち抜き加工からプレス時間まで時間を要する場合は、保冷環境で保管して下さい。